

匀胶机（涂胶机）产品简介

匀胶机（涂胶机）用于半导体硅片，载玻片，晶片，基片，ITO 导电玻璃等工艺，制版的表面涂覆，具有转速稳定和启动迅速等优点，保证涂胶厚度的一致性和均匀性，30 年来产品精心打造，独家技术国内市场占有率第一。

联系电话：010-82995689 010-82995634 联系人：杨进 高级工程师

单位销售 QQ：2189047197

研制单位：中国科学院微电子研究所 <http://www.ime.ac.cn/>

具体资料查看：微电子设备仪器中心

http://www.ime.cas.cn/jgsz/kybm/lab11/lab11_2/

选型参考：

1、 $\Phi 5$ - $\Phi 100$ mm 圆片，最大 100×100 mm² 方片 选用 KW-4 系列产品

2、 $\Phi 100$ - $\Phi 200$ mm 圆片（4 英寸~8 英寸），选用 KW-5 产品

3、 $\Phi 200$ - $\Phi 600$ ， 200×200 mm²*~ 500×500 mm² 方片，单独定制产品 KWD



KW-4T 型

台式匀胶机

中国科学院微电子研究所独家最新设计

全新触摸屏

技术参数及要求:

基片尺寸: $\Phi 5$ - $\Phi 100$ mm 圆片, 最大 100×100 mm² 方片

转速: 250-9000RPM

旋涂设置: 任意阶段之间均可任意升降调节

转速稳定性: $< \pm 1\%$

旋涂均匀性: $< 1\%$

旋涂工艺阶段: 6 段

旋涂时间: 单步工艺 0-1800s, 可根据客户需求调节

整机尺寸 (长宽高): 210mm \times 280mm \times 248mm

裸机尺寸 (长宽高): 210mm \times 280mm \times 155mm

电机功率: 40W

适应材料: 硅片、玻璃、石英、金属、GaAs、GaN、InP 等各种材料

配套无油真空泵参数:

型号: KW-550A/KW-550T

抽速: 1.5 升/秒

功率: 320W

噪音: 50db

最低真空度: -700mmHg

重量: 7.3Kg

尺寸(长宽高): 240mm \times 160mm \times 230mm

抽气速率: > 60 L/min



KW-4A 型 台式匀胶机

中国科学院微电子研究所独家设计制造

技术参数及要求:

基片尺寸: $\Phi 5$ - $\Phi 100$ mm 圆片, 最大 100×100 mm² 方片

转速: 500-8000RPM

转速稳定性: $< \pm 1\%$

旋涂均匀性: $< 1\%$

旋涂工艺阶段: 2 段

旋涂时间: I 速 0~18S, 最大 (0~60S); II 速 0~60S, 最大 (0~180S)

整机尺寸 (长宽高): 210mm \times 260mm \times 275mm

裸机尺寸 (长宽高): 210mm \times 260mm \times 155mm

电机功率: 40W

适应材料: 硅片、玻璃、石英、金属、GaAs、GaN、InP 等各种材料



KW-5 型 台式匀胶机

中国科学院微电子研究所独家设计制造

技术参数及要求：变频调速

基片尺寸：Φ100-Φ200mm（4英寸~8英寸）

转速：500-5000 转/分

转速稳定性：±1%

旋涂均匀性：±5%

旋涂工艺阶段：2 段

旋涂时间：I 速 0~18S；II 速 0~60S

整机尺寸（长宽高）：425 mm×500 mm×300 mm

裸机尺寸（长宽高）：425mm×500mm×190mm

电机功率：180W

适应材料：硅片、玻璃、石英、金属、GaAs、GaN、InP 等各种材料



KWD 型

台式匀胶机

中国科学院微电子研究所独家设计制造

技术参数及要求：变频调速

基片尺寸：Φ200-Φ600，200mm*200mm* ~500mm*500mm 方片

显示转速：200-2000 转/分，±0.5%精度

转速稳定性：±1%

旋涂均匀性：±5%

旋涂工艺阶段：2 段

旋涂时间：3~60S

最大加速度：最高加速度 $\geq 500\text{rpm/sec}$

整机尺寸：980mm \times 855mm \times 855mm

电机功率：320W

适应材料：硅片、玻璃、石英、金属、GaAs、GaN、InP 等各种材料

真空泵抽气速率：无（可根据客户需求提供）

联系方式

地 址：北京市朝阳区北土城西路 3 号

邮政编码：100029

联系电话：010-82995689 010-82995634

联系人：杨进